

## 本期封面



2001年1期

栏目:

DOI:

论文题目: 扩散处理对Ag-Cu复合板界面区组织与成分的影响

作者姓名: 孟亮 陈燕俊 刘茂森 周世平 杨富陶 林德仲

工作单位: 浙江大学金属材料研究所, 杭州310027

通信作者: 孟亮

通信作者Email: [mengliang@cmsce.zju.edu.cn](mailto:mengliang@cmsce.zju.edu.cn)

文章摘要: 研究了冷轧Ag-Cu层状复合板在扩散处理条件下结合面区域微观组织及成分分布的变化. 400及750℃扩散处理可使复合板发生再结晶或晶粒粗化. 在750℃扩散处理可导致沿结合面Ag侧形成细晶区, 并析出次生相, 同时使结合面上出现空洞. 随扩散时间延长, 细晶区宽度增加, 次生相数量增多, 空洞也趋于连续分布.

关键词: 复合板材, 界面, 扩散, 显微组织

分类号: TG111.6, TG156.21

关闭